

WEST☐ Generate Collection

Print

JP 62-174221

L19: Entry 10 of 17

File: DWPI

Jul 31, 1987

DERWENT-ACC-NO: 1987-253380

DERWENT-WEEK: 198736

COPYRIGHT 2003 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: One component epoxy! resin compsns. - comprise e.g. bisphenol=a epoxy! resin and hardeners e.g. bisphenol=a and urea cpds.

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

CODE

MATW

PRIORITY-DATA: 1986JP-0016201 (January 27, 1986)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
JP 62174221 A	July 31, 1987		004	

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
JP 62174221A	January 27, 1986	1986JP-0016201	

INT-CL (IPC): C08G 59/40

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 62174221A

BASIC-ABSTRACT:

The resin compsns. contain (1) cpds. contg. above two epoxy gps. in mol. (2) cpds. contg. above 2 OH gps. in mol. in an amt. of above 0.1 mole and below 1.3 mole in OH to 1 mole of epoxy gp. of (1) and (3) urea cpds. of formula (I) in an amt. of above 0.01 mole and below 0.1 mole to 1 mole of epoxy gp. (where R1, R2 = H or Cl).

(1) Includes e.g. bisphenol A epoxy resin, polyethylene glycol diglycidyl ether. (2) Acting as a hardener includes e.g. bisphenol A, trimethylolpropane. (3) Being used as a hardener includes e.g. (p-chlorophenyl)-N,N-dimethylurea (Cpd. I) (3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea (Cpd. II). The resin compsns. may be blended with fillers, colouring agents, diluents, levelling agents, etc..

USE/ADVANTAGE - The resin compsns. are used as adhesives, sealants, potting agents and insulation paints. They show high curing velocity at low temp. and have excellent heat resistance and adherence.

In an example 'Epikote 828' (RTM), bisphenol A and Cpd. II were blended in a total amt. of 50 g in an OH-mole number to 1 mole of epoxy gp. being 0.34 and in a Cpd. II-mole number to 1 mole of epoxy gp. being 0.045. The mixt. was kneaded for 20 minutes The resin compsn. had a gelation time of 70 secs. at 160 deg.C The compsn. cured when heated at 100 deg.C for 1 hr..

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: ONE COMPONENT POLYEPOXIDE RESIN COMPOSITION COMPRISE BISPHENOL=A POLYEPOXIDE RESIN HARDEN BISPHENOL=A UREA COMPOUND

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭62-174221

⑪ Int.Cl.⁴
C 08 G 59/40

識別記号
MHX

庁内整理番号
6561-4J

⑬ 公開 昭和62年(1987)7月31日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 一液性エポキシ樹脂組成物

⑮ 特 願 昭61-16201

⑯ 出 願 昭61(1986)1月27日

⑰ 発 明 者	福 井	太 郎	門真市大字門真1048番地	松下電工株式会社内
⑱ 発 明 者	橋 本	真 治	門真市大字門真1048番地	松下電工株式会社内
⑲ 発 明 者	日 野	裕 久	門真市大字門真1048番地	松下電工株式会社内
⑳ 発 明 者	辻 本	雅 哉	門真市大字門真1048番地	松下電工株式会社内
㉑ 出 願 人	松下電工株式会社		門真市大字門真1048番地	
㉒ 代 理 人	弁理士 松本 武彦			

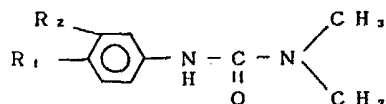
明 細 書

1. 発明の名称

一液性エポキシ樹脂組成物

2. 特許請求の範囲

(1) 分子内にエポキシ基を2個以上有する化合物を含むとともに、分子内にOH基を2個以上有する化合物をエポキシ基1モルに対してOH基が0.1モル以上1.3モル以下となるような割合で含み、かつ、以下に示す尿素化合物をエポキシ基1モルに対して0.01モル以上0.1モル以下の割合で含む一液性エポキシ樹脂組成物。



(R₁, R₂ はHまたはC1)

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

この発明は、接着材、シール材、ポッティング材、絶縁塗料等に用いられる一液性エポキシ樹脂組成物に関する。

(背景技術)

エポキシ樹脂は、耐熱性、絶縁性、密着性等に優れているため、接着材、シール材、ポッティング材、絶縁塗料等に有用である。しかし、二液性のものは、配合、脱泡、ポットライフに問題があり使いづらい。一方、一液性のものは、このようなことはあまり問題とならないが、一般に知られている硬化剤のジシアンジアミドや有機酸ヒドライド等を用いた場合、硬化温度が高くなるという問題があり、イミダゾール化合物やBF₃のアミン塩等を用いた場合、二液性のものに比べて耐熱性、密着性が劣るという問題がある。

そのため、低温でも硬化速度が速く、二液性のエポキシ樹脂と同等あるいはそれ以上の性能を有する一液性エポキシ樹脂組成物が望まれていた。

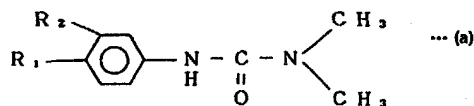
(発明の目的)

この発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、低温でも硬化速度が速く、そのうえ、耐熱性、密着性等の硬化物性能も優れた一液性エポキシ樹脂組成物を提供することを目的とし

ている。

(発明の開示)

前記のような目的を達成するため、この発明は、分子内にエポキシ基を2個以上有する化合物を含むとともに、分子内にOH基を2個以上有する化合物をエポキシ基1モルに対してOH基が0.1モル以上1.3モル以下となるような割合で含み、かつ、以下に示す尿素化合物をエポキシ基1モルに対して0.01モル以上0.1モル以下の割合で含む一液性エポキシ樹脂組成物をその要旨としている。



(R₁, R₂ はHまたはC₁)

以下に、この発明を詳しく説明する。

分子内にエポキシ基を2個以上有する化合物としては、たとえば、ビスフェノールAタイプのエポキシ樹脂、ノボラックタイプのエポキシ樹脂、ビスフェノールFタイプのエポキシ樹脂、脂環式

なるようにして配合される。OH基が0.1モル未満になると硬化時間が長くなり、1.3モルを越えると得られる硬化物の物性が低下するからである。

尿素化合物は硬化剤として用いられる。この化合物は、前記式(a)であらわされるものであって、具体的には、たとえば、(p-クロロフェニル)-N・N-ジメチル尿素、(3・4-ジクロロフェニル)-N・N-ジメチル尿素等があげられる。この尿素化合物が2種以上併用されるようであってもよい。

前記尿素化合物は0.01モル以上0.1モル以下配合される。0.01モル未満になると硬化時間が長くなり、0.1モルを越えると得られる硬化物の物性が低下するからである。

前記エポキシ基を有する化合物、OH基を有する化合物および尿素化合物のほか、使用目的等に応じ、樹脂組成物としての必要な特性を出すために一般に用いられている充填材、着色剤、希釈剤、レベリング剤、脱泡剤、その他の変性剤等が用

エポキシ樹脂、ポリエチレングリコールのジグリシジルエーテル、ポリプロピレングリコールのジグリシジルエーテル等の液状エポキシ樹脂があげられ、2種以上が併用されるようであってもよい。また、液状でないものであっても、液状のものに溶解して全体として液状となるものであればよい。

分子内に2個以上のOH基を有する化合物は硬化剤として用いられる。この化合物としては、ビスフェノールA、ビスフェノールF、トリメチロールプロパン、フェノールノボラック樹脂、ハイドロキノン、カテコール、レゾルシン、エチレングリコール、プロピレングリコール、1・4-ブタンジオール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ペンタエリスリトール、ポリバラビニルフェノール等があげられ、2種以上が併用されるようであってもよい。

前記OH基を有する化合物は、エポキシ基1モルに対してOH基が0.1モル以上1.3モル以下と

いられるようであってもよい。

以上のような原材料を混ぜ合わせると、この発明にかかる一液性エポキシ樹脂組成物が得られる。この樹脂組成物は、前記のようなエポキシ基を有する化合物が含まれるとともに、硬化剤としてOH基を有する化合物および尿素化合物が併用されて、両者が前記のような割合で含まれるので、低温でも硬化速度が速く、そのうえ、耐熱性、密着性等の硬化物性能も優れたものとなるのである。

つぎに、実施例および比較例について説明する。

以下の実施例および比較例では、ビスフェノールA型エポキシ樹脂として、油化シェルエポキシ樹脂のエピコート828を用い、ビスフェノールA、(3・4-ジクロロフェニル)-N・N-ジメチル尿素、トリメチロールプロパン、(p-クロロフェニル)-N・N-ジメチル尿素として、それぞれ、半井化学薬品㈱のものを用いることとした。

(実施例1～4および比較例1～4)

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(エピコート828)、ビスフェノールAおよび(3・4-ジクロルフェニル)-N・N-ジメチル尿素を、全量が50gとなるようにするとともに、エポキシ基1モルに対するOH基のモル数および尿素化合物のモル数が第1表に示されている割合となるようにして配合し、この配合物を真空らいかい機によって20分間混練して一液性エポキシ樹脂組成物をつくった。

(実施例5, 6)

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(エピコート828)、トリメチロールプロパンおよび(p-クロルフェニル)-N・N-ジメチル尿素を、第1表に示されている割合で配合するようにし、前記実施例1等と同様にして一液性エポキシ樹脂組成物をつくった。

(比較例5)

ビスフェノールA型エポキシ樹脂(エピコート828)およびトリメチロールプロパンを、第1

表に示されている割合で配合するようにし、前記実施例1等と同様にしてエポキシ樹脂組成物をつくった。

第1表

	エポキシ基1モルに対するOHのモル数	エポキシ基1モルに対する尿素化合物のモル数	ゲル化時間(160℃)
実施例1	0.34	0.045	70秒
実施例2	0.15	0.07	80秒
実施例3	1.0	0.015	150秒
実施例4	0.5	0.09	40秒
比較例1	1.0	—	ゲル化せず
比較例2	—	0.2	発泡するがゲル化せず
比較例3	1.0	0.005	20分以上
比較例4	0.08	0.08	20分以上
実施例5	0.6	0.04	130秒
実施例6	0.9	0.02	100秒
比較例5	0.9	—	ゲル化せず

(実施例7～12)

第2表に示されているエポキシ樹脂と、分子内にOH基を2個以上有する化合物(表では「OH化合物」と記した)、および、(3・4-ジクロルフェニル)-N・N-ジメチル尿素を、全量が50gになるようにするとともにエポキシ基1モルに対して、OH基が0.6モル、尿素が0.04モルになるようにして配合し、この配合物を真空らいかい機によって20分間混練して一液性エポキシ樹脂組成物をつくった。ただし、フェノールノボラックエポキシ樹脂としては、住友化学工業製のELPN180を、脂環式エポキシ樹脂としては、UCC社製のERL4221を、ポリエチレングリコール(PEG)ジグリシジルエーテルとしては、油化シェルエポキシ製のYED205をそれぞれ用いることとした。

第 2 表

実施例	エポキシ樹脂	OH化合物	ゲル化時間 (160℃)
7	ビスフェノールA型 エポキシ樹脂	カチコール	90秒
8	ビスフェノールA型 エポキシ樹脂	1・4-ブタンジオール	180秒
9	ビスフェノールA型 エポキシ樹脂	ペンタエリスリトール	70秒
10	フェノールノボラック エポキシ樹脂	ビスフェノールA	60秒
11	脂環式エポキシ樹脂	ビスフェノールA	170秒
12	ポリエチレングリコール ジグリシジルエーテル	ビスフェノールA	220秒

特開昭62-174221 (4)

実施例1～12および比較例1～5の一液性エポキシ樹脂組成物につき、160℃におけるゲル化時間を測定した。結果を第1表および第2表に示す。

第1表および第2表より、実施例1～12は、比較例1～5がゲル化時間が長く、あるいは、ゲル化しないのに対し、ゲル化時間が短く、硬化速度が速いことがわかる。なお、実施例1～4につき、100℃で1時間加熱したところ、いずれも硬化し、硬化時間が短いことがわかった。

(発明の効果)

この発明にかかる一液性エポキシ樹脂組成物は、分子内にエポキシ基を2個以上有する化合物を含むとともに、分子内にOH基を2個以上有する化合物をエポキシ基1モルに対してOH基が0.1モル以上1.3モル以下となるような割合で含み、かつ、前記(a)式で示される尿素化合物をエポキシ基1モルに対して0.01モル以上0.1モル以下の割合で含むので、低温でも硬化速度が速く、そのうえ、耐熱性、密着性等の硬化物性能も優れてい